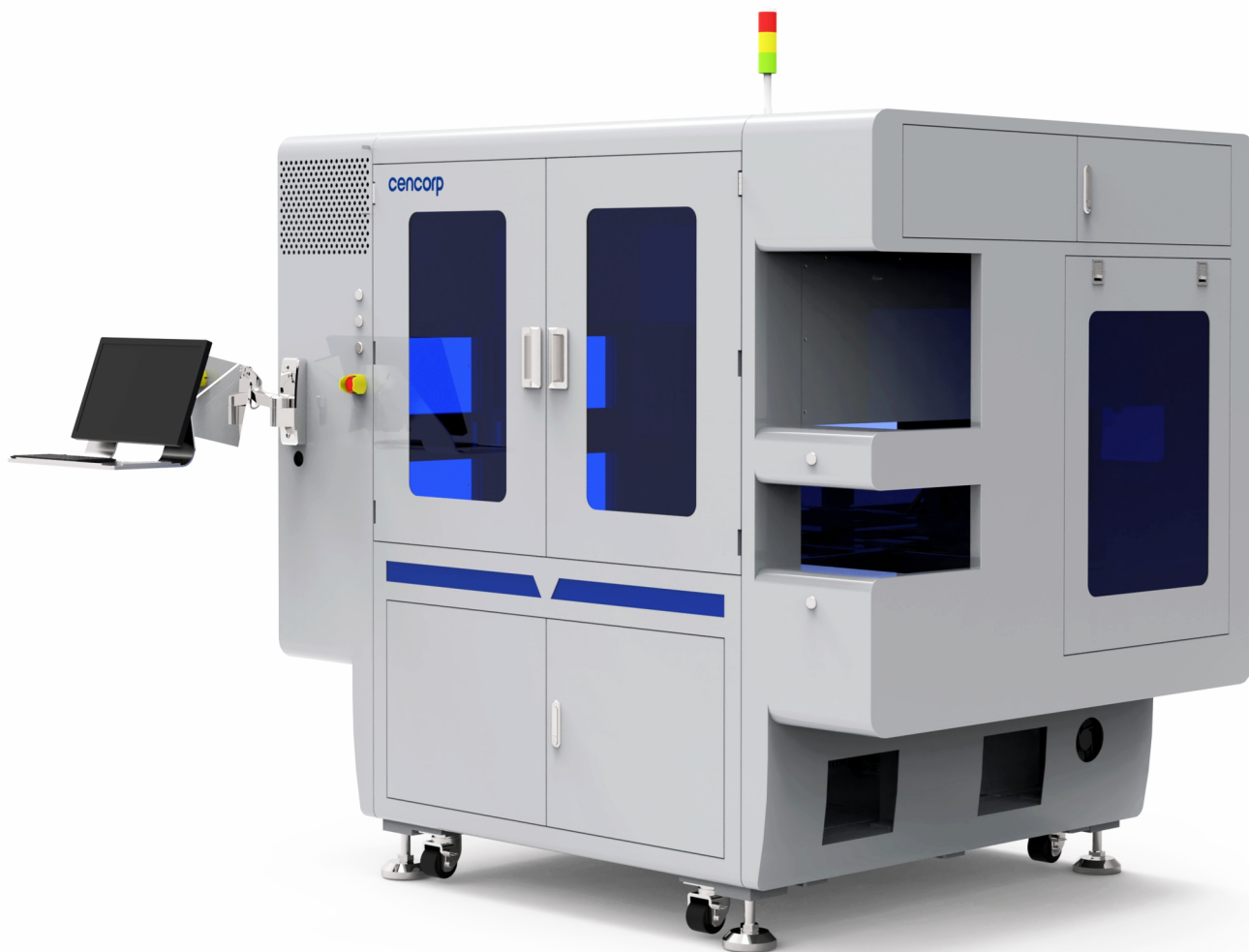


3600 CF

半导体系列

半导体自动翻膜设备



Cencorp 3600 CF适用于半导体封装和测试工序的芯片自动移动和翻转,适用于集成芯片(IC)、微机电传感芯片(MEMS)、方形扁平无引脚封装芯片(QFN)、带引线塑料芯片载体封装芯片(PLCC)等。

良好的兼容性

可处理各种颜色、厚度的芯片

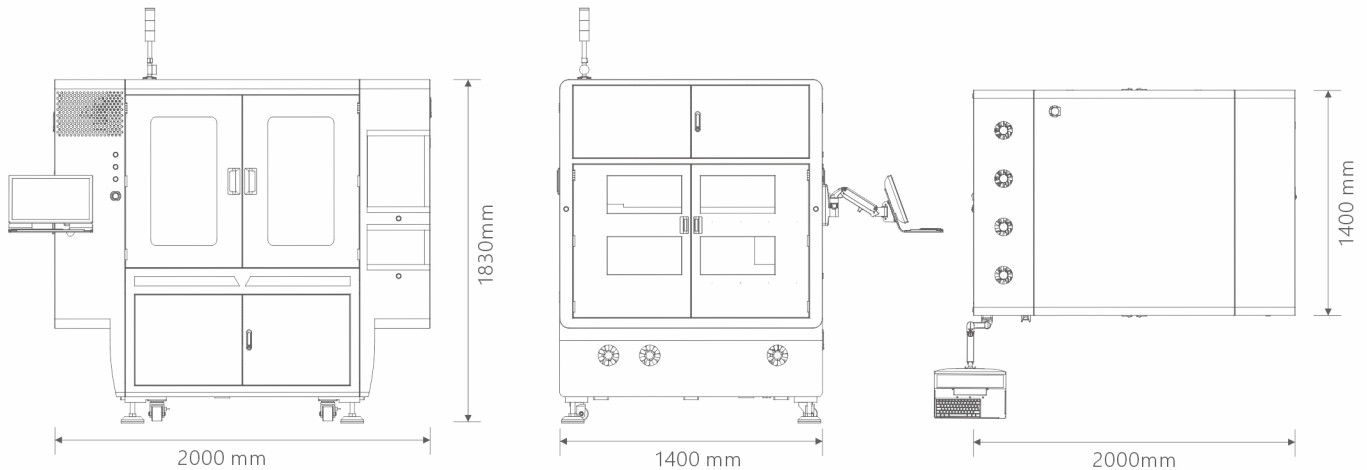
可实现精准去除、识别和翻转功能

可全自动上料、撕膜、处理废膜、下料

可自动识别并处理不同胶带的物料

3600 CF

技术参数



设备基本参数

宽度: 2000mm
深度: 1400mm
高度: 1830mm
重量: 1840kg

设备精度

重复定位精度 (x, y, z): ± 0.005 mm
系统精度: ± 0.02 mm

载具处理能力

弹匣

基础功能

安全互锁门
可调节抓取头
平均无故障间隔时间: 168小时
平均辅助间隔时间: 4小时
平均修复时间: 15分钟
平均辅助时间: 3分钟
静电防护等级: 0级
噪音: < 75dB

用户界面

运行系统: Windows
网络连接: 可选
双显示器: 可选

视觉系统

自动校准
二维码识别
异常识别检测
离线分析
膜料识别

可选功能

坏板识别
条码类型: 1D or 2D
支持SECS/GEM
绝对精度校准
支持MES追溯系统
本地数据管理系统
离线编程

电气要求

电压: 交流 220/110V
频率: 50/60Hz
最大功率: 5KW

环境要求

工作温度: 10-40°C
工作湿度: 30%-85%